【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成17年6月30日(2005.6.30)

【公開番号】特開2000-12730(P2000-12730A)
【公開日】平成12年1月14日(2000.1.14)
【出願番号】特願平10-175839
【国際特許分類第７版】
　ＨＯ１Ｌ　23/12
　ＨＯ１Ｌ　23/14
【ＦＩ】
　ＨＯ１Ｌ　23/12　　Ｌ
　ＨＯ１Ｌ　23/12　　Ｆ
　ＨＯ１Ｌ　23/14　　Ｍ
　ＨＯ１Ｌ　23/14　　Ｒ

【手続補正書】
【提出日】平成16年10月15日(2004.10.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　【０００８】
　　【発明を解決するための手段】
　本発明は、２５℃で５ＧＰａ以上の曲げ弾性率を有する補強樹脂を、ＢＧＡパッケージのハンダボール搭載面の外周に形成したＢＧＡパッケージに関する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　このような樹脂として、硬化物が２５℃で約１２ＧＰａの曲げ弾性率を持つハイソール社ＣＢ０１１－１Ｒが挙げられる。